



Ver la ficha técnica
en línea

/ CWB/18-60-MVS SERIE



/ Uso

Las herramientas CWB/18-60-MVS permiten quitar fácilmente la semiconductora no pelable (vulcanizada) sin silicona y haciendo un chafán paro del semiconductor. El tope MVS sirve para las herramientas CWB/18-60-MVS y tiene una area de contacto grande con la herramienta.

/ Ventajas

- Sin silicona
- La profundidad de corte se hace por paso de 0.1 mm
- Resistente
- Fácil de manejar
- Ajuste muy fino de la profundidad de corte
- Le temps de ponçage requis est très faible, voire quasiment superflu

/ Areas de actividad

-  Cables & conexiones
-  Distribución de electricidad
-  Industria
-  Sub-estaciones

/ Características

- **Herramientas específicas** : Herramientas para cables
- **Herramientas para cables** : Herramientas de preparación de cables
- **Áreas de actividad** : Cables & conexiones, Distribución de electricidad, Industria, Sub-estaciones
- **Para cables de red** : media tensión
- **Embalaje** : Caja de cartón
- **Peso (g)** : 900
- **Longitud (mm)** : 235
- **Ancho (mm)** : 125
- **Altura (mm)** : 90
- **Diámetro máximo (mm)** : 60
- **Diámetro mínimo (mm)** : 18
- **Profundidad de corte MAX (mm)** : 1.8
- **Tools king** : Specific tools

Product reference	Profundidad de corte MAX	Ángulo de chaflán
CWB/18-60-MVS	1.8 mm	13 °
CWB/18-60-MVS-8	1,8 mm	8 °